

2021 年度医療・創薬データサイエンスコンソーシアム
「データサイエンス人材育成プログラム」受講生募集要項(企業人材コース)

1. 目的

東京医科歯科大学では文部科学省補助事業として「データ関連人材育成プログラム」を実施しています。医療・創薬分野において我が国を代表する研究者や企業が集う『知のコミュニティ』（Open Innovation の場）を創設し、研究会活動や、医療・創薬分野における次世代のデータサイエンス専門人材を育成します。

ライフサイエンスや情報学等のバックグラウンドを持ち、医療・創薬データサイエンス領域での活躍を志す受講生を募集します。

2. 求める人材像

（基礎編修了を目指す場合）

- * 基礎的な数学（統計学等）や情報学の素養を身につけ、基本的なデータ解析スキルの習得を目指す人材。
- * 基礎編修了後、応用編にチャレンジする意欲のある人材。

（応用編修了を目指す場合）

- * ビッグデータ医療あるいは AI 創薬を学習するために必要なデータ解析の基礎知識・スキルを習得している人材。
- * データサイエンス専門人材として研究機関や企業で活躍し、我が国のこの分野における国際競争力の向上に寄与しようとする志を持つ人材。
- * 積極的に研修やワークショップ等に参加し、実践的な能力の研鑽に取り組む人材。

3. 募集人数

30 名程度

4. 出願条件

連携機関に所属する者

5. 受講料

A 会員：200 万円（税抜） 企業（B 会員は除く）

B 会員：100 万円（税抜） ベンチャー企業（従業員 50 名以下、設立 5 年以内）

東京医科歯科大学データ関連人材育成プログラム運営委員会において 2 名以上の受講が認められた企業については、2 名目から 1 名につき 50 万円（税抜）を支払う。受講料については、東京医科歯科大学が業務委託する株式会社シード・プランニングから別途請求を行う。

6. 出願方法及び出願期間

医療・創薬データサイエンスコンソーシアムのホームページ（<http://md-dsc.com/>）より、申込みを行ったうえで、次の出願書類を提出すること。

（1） 出願期間

2021 年 3 月 16 日（火）～2021 年 4 月 28 日（水）

※社内事情等により、締切日までに出席が難しい方はご相談ください。

(2) 出願書類

履歴書（写真添付、志望動機等記入）、推薦状

(3) 出願書類提出先

電子ファイルで提出する場合（推奨）：bosyu-data@ml.tmd.ac.jp

郵送で提出する場合：〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45

東京医科歯科大学 学務企画課 大学院教務第一係

7. 選考方法

データ関連人材育成プログラム運営委員会において、当コンソーシアムが求める人材像に適合しているかどうか出願書類により判断する。

8. 個人情報の取り扱い

個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「国立大学法人東京医科歯科大学個人情報管理規則」に基づき、次のとおり取り扱う。

- (1) 個人情報の利用は、本募集にかかる選抜に利用するほか、選考後の受講登録、イベントの周知等に利用する。
- (2) 上記の利用については、研修やキャリア形成支援活動の実施のため「国立大学法人東京医科歯科大学データ関連人材育成プログラム実施のためのコンソーシアム実施規則」で規定する参画機関、連携機関と共有する他、個人情報の適切な取り扱いに関する契約を締結した上で、一部の業務を外部の事業者へ委託することがある。

※関連する法律及び規則

「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000059&openerCode=1

「国立大学法人東京医科歯科大学個人情報管理規則」

<http://www.tmd.ac.jp/cmn/rules/houki/3hen/1shou/2setsu/31205kozin.pdf>

「国立大学法人東京医科歯科大学データ関連人材育成プログラム実施のためのコンソーシアム運営規則」

<http://www.tmd.ac.jp/cmn/rules/houki/10hen/5shou/2setsu/105201dataconsortium.pdf>

9. カリキュラム及び修了要件

別紙参照

10. 本件に関するお問合せ先

〒113-8510

東京都文京区湯島 1-5-45

東京医科歯科大学 学務企画課 大学院教務第一係

TEL : 03-5803-4676

E-mail : grad01@ml.tmd.ac.jp